



UNIVERSIDAD  
POLITÉCNICA  
DE MADRID

I.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

I.B.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES: CONSEJO DE GOBIERNO

I.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  
 I.B.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES: CONSEJO DE GOBIERNO

D. Fernando **VELA COSSÍO**, Secretario General de la Universidad Politécnica de Madrid,

**CERTIFICA:**

Que, en la sesión ordinaria del **CONSEJO DE GOBIERNO** de la Universidad Politécnica de Madrid celebrada, previa convocatoria, el día 26 de septiembre de 2024, se adoptaron válidamente los siguientes acuerdos:

- *Aprobar el Acta de la sesión celebrada el día 23 de julio de 2024.*
- *Aprobar la participación de la UPM como miembro del patronato de la Fundación para la Investigación, Desarrollo y Aplicación de los Materiales Compuestos (FIDAMC), para su posterior elevación al Consejo Social.*
- *Informar favorablemente sobre el Plan de Acción de la UPM para la renovación del sello Estrategia de Recursos Humanos para Investigación (HRS4R, siglas en inglés) de la Comisión Europea, 2024-2029.*
- *Aprobar la inclusión en el Mapa de Títulos de la UPM de las siguientes microcredenciales (se adjunta Anexo):*
  - *Microcredenciales de los títulos de:*
    - *Experto en Diseño y Verificación de Sistemas Integrados Digitales*
    - *Experto en Circuitos Integrados de Señal Mixta y Radiofrecuencia*
    - *Experto Tecnologías Fotónicas y su Integración*
    - *Experto en Fabricación y Evaluación de Dispositivos Microelectrónicos*
  - *Microcredencial Dispositivos Mems Electroacústica*
  - *Microcredencial Laboratorio de Circuitos Integrados*
  - *Microcredencial Diseño, Fabricación y Caracterización de Resonadores Mems Electroacústicos*
- *Aprobar los siguientes Títulos Propios:*
  - *Experto en Diseño y Verificación de Sistemas Integrados Digitales*
  - *Experto en Circuitos Integrados de Señal Mixta y Radiofrecuencia*
  - *Experto Tecnologías Fotónicas y su Integración*
  - *Experto en Fabricación y Evaluación de Dispositivos Microelectrónicos*

Madrid, a 26 de septiembre de 2024

El Secretario General Fernando Vela Cossío  
 Vº Bº El Rector Guillermo Cisneros Pérez

I.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  
 I.B.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES: CONSEJO DE GOBIERNO

**CONSEJO DE GOBIERNO SEPTIEMBRE 2024**

- 1. TÍTULO DE EXPERTO EN DISEÑO Y VERIFICACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DIGITALES (27 ECTS)**
  - 1.1. Diseño VLSI\* Aprobada + carta
  - 1.2. Diseño Digital I Aprobada + carta
  - 1.3. Diseño Digital II Aprobada + carta
  - 1.4. Diseño de procesadores con arquitectura abierta
  - 1.5. Verificación de circuitos digitales
  - 1.6. Diseño de sistemas en chip basados en HW abierto
  - 1.7. Componentes SW para sistemas embebidos
  - 1.8. Diseño de sistemas críticos y de aplicación a espacio
- 2. TÍTULO DE EXPERTO EN CIRCUITOS INTEGRADOS DE SEÑAL MIXTA Y RADIOFRECUENCIA (24 ECTS)**
  - 2.1. Diseño VLSI\* Aprobada + carta
  - 2.2. Diseño Digital I Aprobada + carta
  - 2.3. Diseño Digital II Aprobada + carta
  - 2.4. Arquitecturas digitales para procesado de señal
  - 2.5. Diseño de circuitos integrados analógicos y de radiofrecuencia
  - 2.6. Medidas de circuitos de radiofrecuencia
- 3. TÍTULO DE EXPERTO TECNOLOGÍAS FOTÓNICAS Y SU INTEGRACIÓN (24 ECTS)**
  - 3.1. Tecnologías Fotónicas\* Aprobada + carta
  - 3.2. Comunicaciones Ópticas Avanzadas Aprobada + carta
  - 3.3. Dispositivos semiconductores\* Aprobada + carta
  - 3.4. Caracterización de dispositivos fotónicos Aprobada + carta
  - 3.5. Circuitos fotónicos integrados Aprobada + carta
  - 3.6. Fotónica de Microondas Aprobada + carta
- 4. TÍTULO DE EXPERTO EN FABRICACIÓN Y EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MICROELECTRÓNICOS (24 ECTS)**
  - 4.1. Dispositivos semiconductores\* Aprobada
  - 4.2. Uso básico de Sala Limpia y preparación de muestras para dispositivos semiconductores
  - 4.3. Técnicas de depósito aplicado a la fabricación de dispositivos semiconductores
  - 4.4. Técnicas de litografía en semiconductores\*
  - 4.5. Tecnologías de System in Package
  - 4.6. Caracterización de materiales y dispositivos semiconductores
- 5. MICROCREDENCIAL DISPOSITIVOS MEMS ELECTROACÚSTICA (3 ECTS)**
- 6. MICROCREDENCIAL LABORATORIO DE CIRCUITOS INTEGRADOS (3 ECTS)**
- 7. MICROCREDENCIAL DISEÑO, FABRICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE RESONADORES MEMS ELECTROACÚSTICOS (3 ECTS)**

-----